

TECA 電子連接產業升級研討會

連接器電鍍製程應用與未來趨勢

時 間	2021年05月04日(星期二)	
主辦單位	台灣電子連接產業協會	
地 點	新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號-工研院	
大 綱	1. 連接器電化學製程介紹與原理說明 2. 電鍍製程發展趨勢	
適合聽課對象	電鍍製程相關從業人員或對電化學製程有興趣之相關人士	
預 期 效 益	了解電化學製程設計之思考流程，並推測未來發展趨勢	
講 師	李博士 (現職：工研院材化所經理，經歷：工研院材化所精微成形與表面技術研究室資深研究員，專長：電化學工程、膠體與表面科學、熱電材料)。 薛博士 (現職：某大學理工學院院長，經歷：國立聯合大學能源工程系系主任、教授及能源研究中心主任；工研院綠能所氫能與燃料電池研究室經理；美國 NanoScience 研究員及AMP Inc 研究員；國立清華大學化工系副教授，專長：燃料電池、電化學、能源系統模擬)。	
09：20-10：40	電鍍製程中常用之電化學原理	李博士
10：50-12：10	電鍍製程在半導體/光電產業之應用	薛博士
12：10-13：10	午餐時間	
13：10-14：30	連接器電鍍製程	薛博士
14：40-16：20	電鍍製程之最新發展趨勢	李博士

★費用：會員NT\$3,500元/人；非會員NT\$7,000元/人；工研院及進駐廠商NT\$5,000元/人（費用含講義/午餐/點心/稅，手續費用請自付）請 **Early bird--2021年03月04日前繳費每人現折NT\$500** 匯款始算完成報名，並享有優惠(2人報名9折優惠，3人以上8折優惠)(優惠計算方式：原價先扣early bird費用，再做2人以上報名折扣)

註：1. 欲取消報名需於課程三日前告知，逾時或當日未到課者將郵寄講義，恕不退費亦不接受變更其他課用；

2. 課程三日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費，於課程結束後統一退費作業！

★參加辦法：請先傳真報名或線上報名並來電確認，再將參加費用請以(發票當日領取)

1. 匯款或轉帳，土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2. 線上ATM繳款，網址：<https://webatm.landbank.com.tw/sap/sap2010s?naMID=156173340650001>
3. 即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"現場繳費，酌收報名費5%作業費

★聯絡電話：(03)5910002 林小姐，5910003 朱小姐 傳真：(03)5910009

★因颱風...等天災，新竹縣或新竹市政府，宣布停止上班，則當日課程另擇期舉行。

◎台灣電子連接產業協會研討會 報名表◎

公司全銜	(發票抬頭： <input type="checkbox"/> 同公司名稱 <input type="checkbox"/> 其他_____)				
聯絡地址		統一編號		傳真	
E-mail		聯絡人		電話	
參加者姓名	職稱/工作部門	午餐	手機	mail	分機
		<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷			
		<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷			
		<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷			
費用共計新台幣 _____ 元整，支付方式 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 匯款/轉帳 <input type="checkbox"/> 現場繳費(酌收5%作業費)					

註：學員之手機號碼僅做為開課未到聯繫用

(表格如不敷使用請自行影印)1100504電鍍應用